



インターコネクション研究会 2025年度公開研究会

主催：電子部品実装技術委員会
協賛：スマートプロセス学会(エレクトロニクス
生産科学部会)、京都実装技術研究会、
サーキットネットワーク、JPCA

◆公開研究会のご案内

◆テーマ：革新が進むインターコネクション技術の最新動向

エレクトロニクス実装学会インターコネクション研究会では、下記要領で2025年度公開研究会を開催致します。

今回は、半導体関連、民生機器分野で注目される新規インターコネクション技術を取り上げ、技術紹介と最新動向を各分野でご活躍されている専門家からご紹介して頂きます。実装技術の要素技術であるインターコネクション技術はますますその重要性が高まっており、最新の技術動向を把握するよい機会になることを確信しておりますので、奮ってご参加ください。

開催日時 2025年6月23日(月) 13:00～16:50

開催方式 Hybrid開催(現地開催 & WEB :Zoom Webinarシステム利用)

開催場所； 回路会館地下1F会議室(西荻窪)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:00～13:05

オープニング

インターコネクション研究会

主査

13:05～13:55

テーマ：「基調講演：導電性接着剤の高性能化に向けた基礎研究の進展」

群馬大学 准教授 井上 雅博氏

<概要>

導電性接着剤は代表的な微細接合材料のひとつであるが、電気的、熱的、機械的接合特性をさらに向上させるためには、それらの特性発現のメカニズムに関する学術的基礎の確立が必要である。本講演では、銀および銅フィラーを用いた導電性接着剤について、近年明らかになってきた導電性発現挙動や電極との接合界面組織発達の実態について紹介する。フィラー近傍の界面相の状態変化が界面電気抵抗低下の速度論やフィラーの低温焼結に重要な役割を果たしていることが示唆されており、界面状態制御が今後の微細接合のため材料技術開発の鍵となると考えられる。

13:55～14:35

テーマ：「高熱伝導ダイアタッチ材に求められる接合技術とその評価方法」

ナミックス(株)技術開発本部ダイアタッチG シニアチームリーダー 明道 太樹氏

<概要>

銀焼結ダイアタッチ材のコア技術の発表の後、無加圧接合用のダイアタッチ材、加圧接合用のダイアタッチ材をご紹介する。最後に、加圧接合材が大面積接合用途に使用されることを想定した評価技術についてご紹介する。

14:35～14:50

休憩

14:50~15:30

テーマ：「ポリマー接合技術の新展開

～ポリマーハイブリッド接合・転写/Fusion接合・放熱・シーリング～」

東レ(株) 電子情報材料研究所 研究主幹 藤原 健典氏

<概要>

当社ポリマーハイブリッド接合技術をご紹介後、Fusion接合用マストランスファー転写技術(フォトニクス等への展開例)、TIMの直接接合、ポリマーシーリング接合材料(MEMS)のインターコネクション技術(接着・接合技術、及びその周辺技術)の最新開発概要をご紹介する。

15:30~16:10

テーマ：「IMCめっき技術を活用した新規コネクタ表面処理」

(株)鈴木 取締役執行役員 中島慶昭氏

<概要>

(有)ナプラが保有しているIMC技術を活用し今までの電解めっきでは対応できなかった高耐熱、高耐久、耐腐食優れためっき加工を行う。また、IMCを活用することで希少金属からの代替もターゲットとする。

(株)鈴木は本技術を量産投入できるよう技術開発を行っている。

16:10~16:50

テーマ：「チップレットを支える要素技術 ～各種接合技術からTSV/RDLによる高密度実装まで～」

コネクテックジャパン(株) 取締役専務執行役員 下石坂 望氏

<概要>

導電ペーストや超音波・低温はんだによる低温接合、焼結材、Cuピラー、はんだバンプ接合、インプリント配線・バンプ同時形成ほか低温80℃から高温380℃までの幅広い接合技術による年間400件に及ぶ実装受託開発・製造実績を紹介する。2.5D/3Dチップレット実装課題に対応する世界初「TSV/RDL&実装一気通貫サービス」の最新動向と今後の果たすべき方向性について展望する。

参加要項

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください

定員 現地50名、オンライン100名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:無料、研究会会員:別払い、シニア会員:1,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:15,000円、非会員学生:2,000円、協賛団体会員:5,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、返信メールで公開研究会への参加URLやお支払いに関する情報をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願いいたします。
(お支払い方法:クレジットカード決済またはコンビニ決済のみ)(手数料学会負担)
- ③領収書(宛名会社名選択可)のご発行は、返信メールのマイページから決済後に即日出力が可能です。
- ④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。

*キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

E-mail: info@jiep.or.jp

(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)